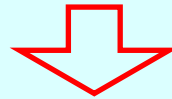
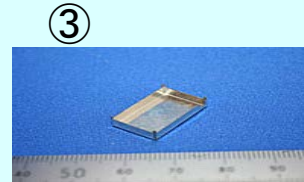
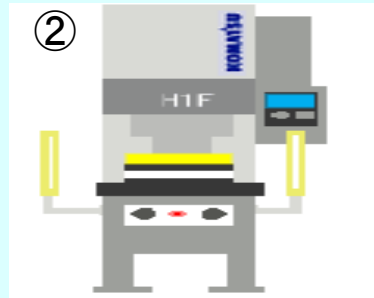
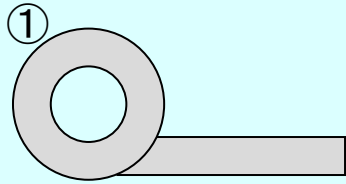


【製品(技術)イメージと特徴】

従来、シールドケースに絶縁体を必要とする場合、下図の様な工程となる。①絶縁被膜が塗装されていない材料を②順送プレス金型へ投入。③従来のシールドケースに④絶縁被膜を手張りしている。結果、コストアップはもちろん、位置精度も悪い。



本研究では、下図の様な工程とした。①パターンプレコート(絶縁被膜付き)材を②位置決め送り装置から③高精度金型へ投入。パターン位置ずれを④ピエゾユニットを使い補正し、⑤シールドケースを製作する。結果、1工程で行なうため安価で、位置精度も向上する。

